

# ET-MKC

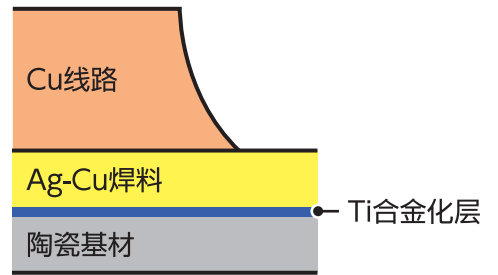
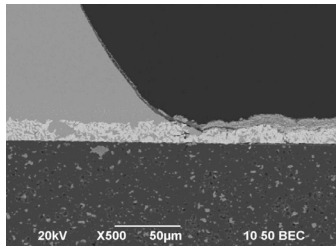
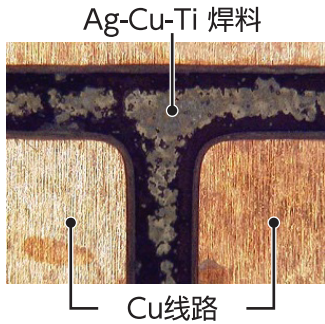
## 散热板（散热片） / DBC基板上Ag-Cu-Ti 焊料清除工艺

1

Ag-Cu-Ti 焊料清除前

### 散热板(散热片)

Cu与陶瓷基材使用Ag-Cu-Ti 焊料焊接。

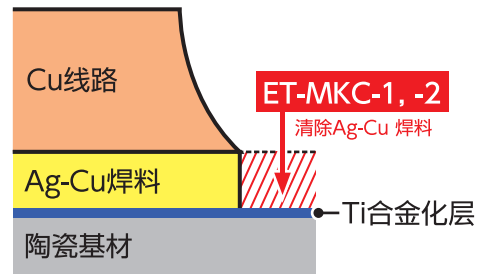
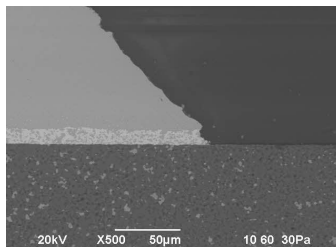
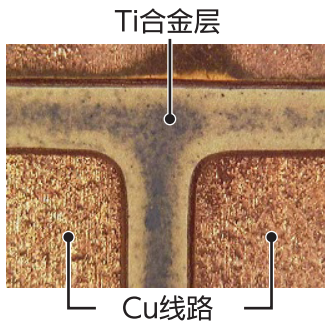


2

清除Ag-Cu焊料

### ET-MKC-1, -2处理 (清除Ag-Cu焊料)

抑制Cu线路的溶解,同时清除Ag-Cu焊料。

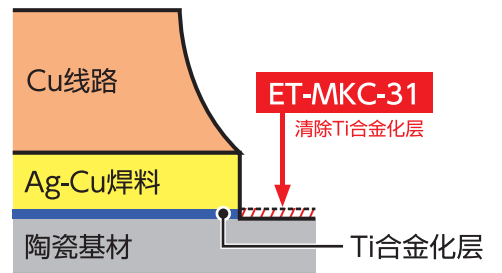
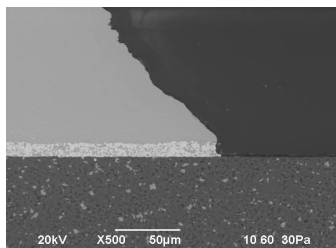
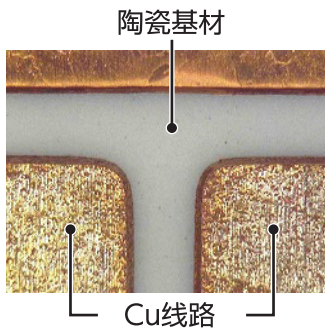


3

清除Ti合金化层

### ET-MKC-31 (清除Ti合金化层)

抑制Cu线路, Ag-Cu焊料的溶解,同时清除Ti合金化层。  
抑制Cu线路与陶瓷基材间的Ag-Cu焊料溶解,无底切生成。  
处理液寿命优良。(可多次处理)



4

微蚀刻处理

### 微蚀刻处理 (形成嵌边角)

微蚀刻Cu线路,整体表面均一化。  
形成高结合强度的嵌边角。

